

セミコン応用物理学会企画基調講演

集積化MEMS技術の現状と今後の展開

応用物理学会
集積化MEMS技術研究会
委員長 石田 誠
豊橋技術科学大学

近年、MEMS技術とLSI技術との融合は、重要な課題であり **More than Moore** の一つの解として期待され研究開発が活発化しています。そういう中で「集積化MEMS技術」という言葉が定着し始めてきています。

集積化MEMSデバイスは、半導体産業の次のビジネスキーデバイスと考えられ、半導体市場の拡大に向けて大きく期待されています。このような背景で、昨年、応用物理学会では、集積化MEMS技術研究会を発足し、より本技術の産業化と学術的連携を見据えた活動を行ってきました。今回、本セミコンにおいて応用物理学会集積化MEMS技術研究会によりMEMSの基調講演を企画いたしました。集積化MEMS技術の現状及び将来についてご講演を頂く予定です。

この基調講演では、集積化MEMS技術の現状と今後の展開についてお話いただく予定です。

世話人 秦 誠一
東京工業大学

12月3日

- | | | | | | | |
|---|-------|---|-------|---------------------|------|----------------|
| ① | 10:30 | - | 11:30 | 集積化MEMS技術の課題と展望 | 益 一哉 | 東工大 |
| ② | 11:30 | - | 12:00 | 集積化CMOS-MEMS技術とその応用 | 町田克之 | NTTアドバンステクノロジー |
| ③ | 12:00 | - | 12:30 | 集積化CMOS-MEMS統合設計・製作 | 年吉 洋 | 東京大学 |